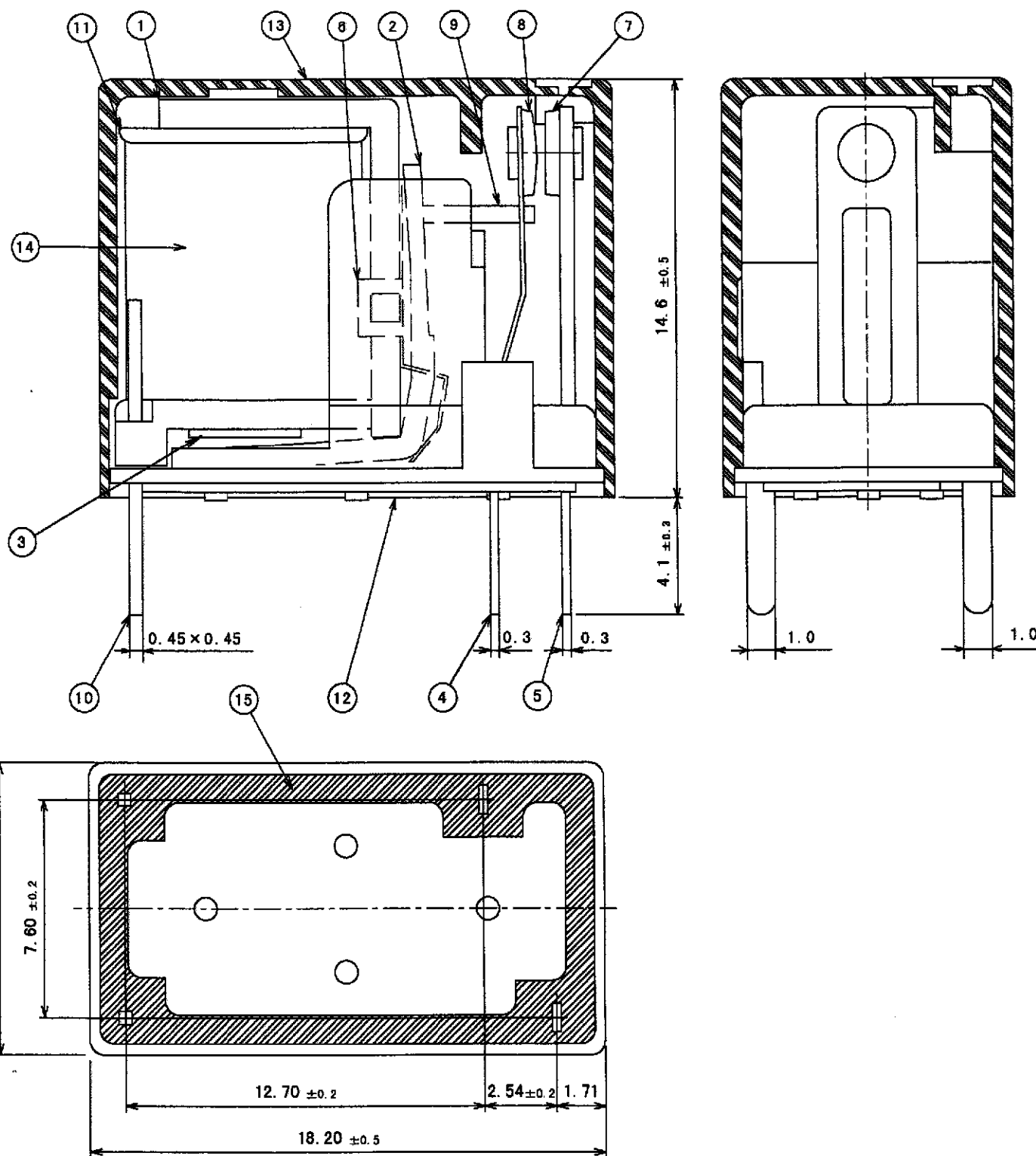
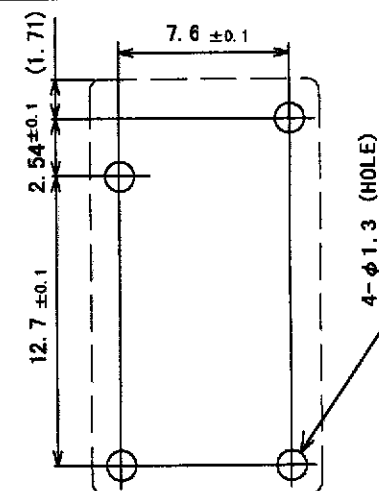


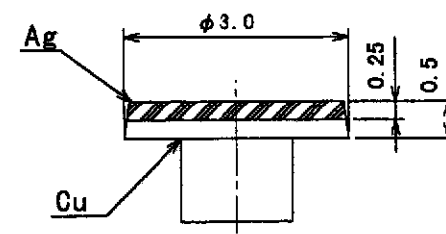
▲ . .
 ▲ . .
 ▲ . .



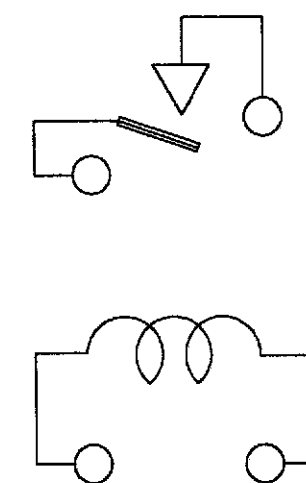
DRILLING DIAGRAM (BOTTOM VIEW)



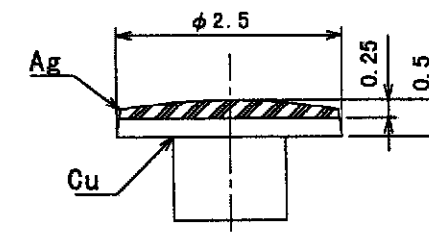
#7 S-CONTACT (10/1)



CONNECTION DIAGRAM

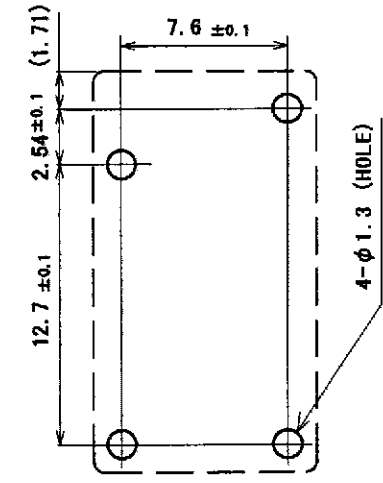
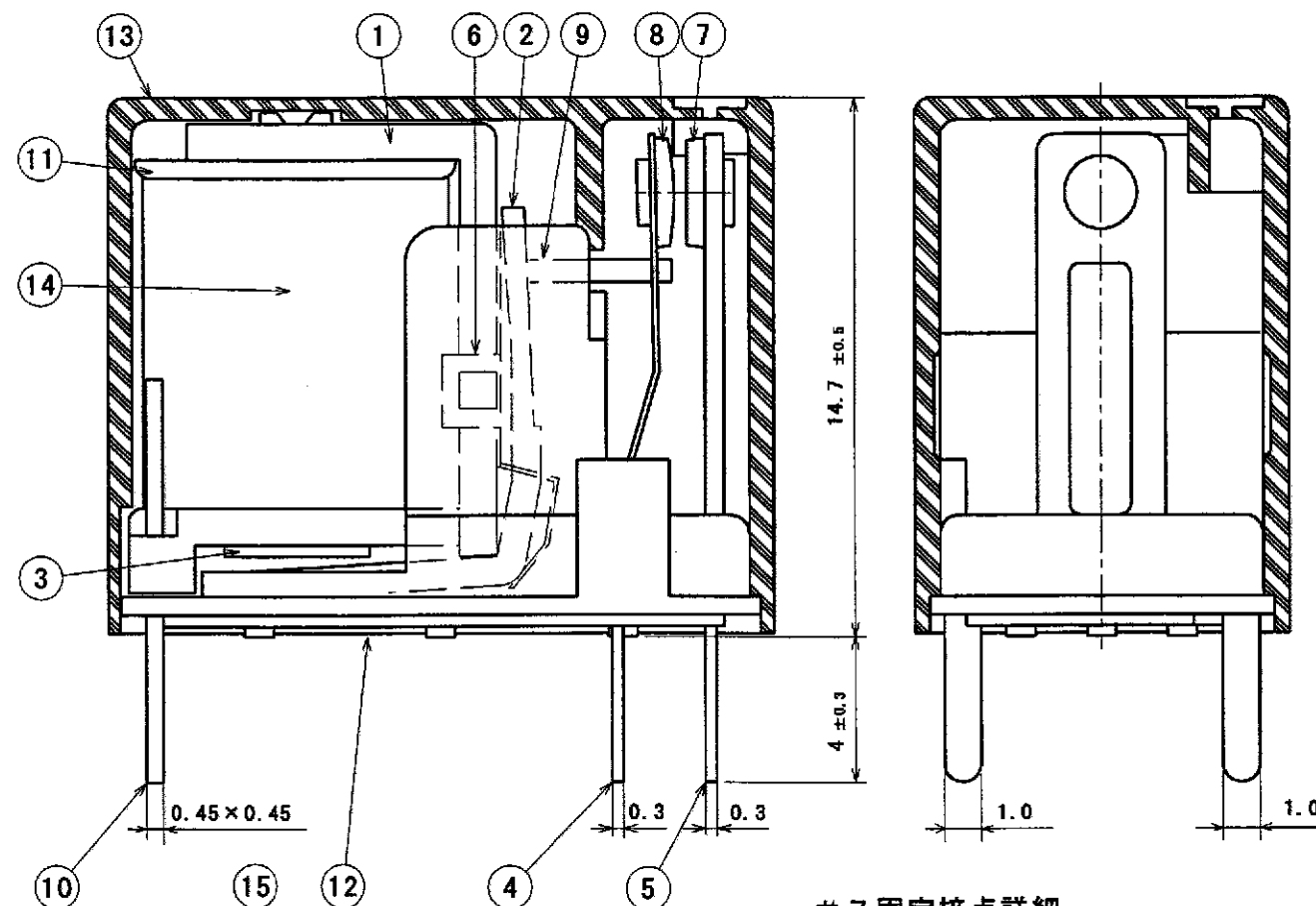


#8 C-CONTACT (10/1)

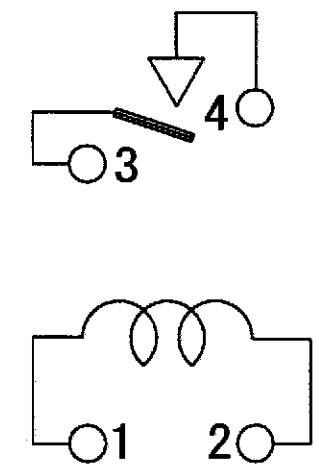


15	RESIN	EPOXY		
14	MAGNET WIRE	UEW		Cass E
13	CASE	P. B. T	94V-0	mitsubishi 5010GN6-15 E53664
12	BASE	P. B. T	94V-0	mitsubishi 5010GN6-30 E53664
11	BOBIN	P. B. T	94V-0	mitsubishi 5010GN6-30 E53664
10	COIL TERMINAL	C. P. WIRE	SOLDER DIP	0.45 x 0.45
9	CARD	P. P. S	94V-0	TOSO G-10 E102861
8	C-CONTACT	Ag		
7	STATIONRY CONTACT	Ag		
6	HINGE SPRING	PHOSPHER BRONZE		0.12t
5	A-TERMINAL	PHOSPHER BRONZE	SOLDER DIP	0.3t
4	C-TERMINAL	PHOSPHER BRONZE	SOLDER DIP	0.12t
3	CORE	STEEL	ANNEAL FNM2	φ 3.0
2	ARMATURE BRACKET	STEEL	ANNEAL FNM2	0.8t
1	FRAME BRACKET	STEEL	ANNEAL FNM2	1.0t
ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH	UL-94 NOTES
DRAWN	M. INNAMI	SCALE	TYPE:	ISSUE: 24, Jan, 1996
CHECK	T. Z. Ray	5/1	OJE-SS/SH-1**LM	DRAWING NO.:
APPROVE	K. NARA			U-1123E-00

△1 . . .
△2 . . .
△3 . . .

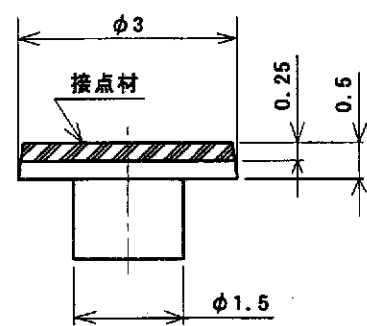


プリント基板加工図
(BOTTOM VIEW)

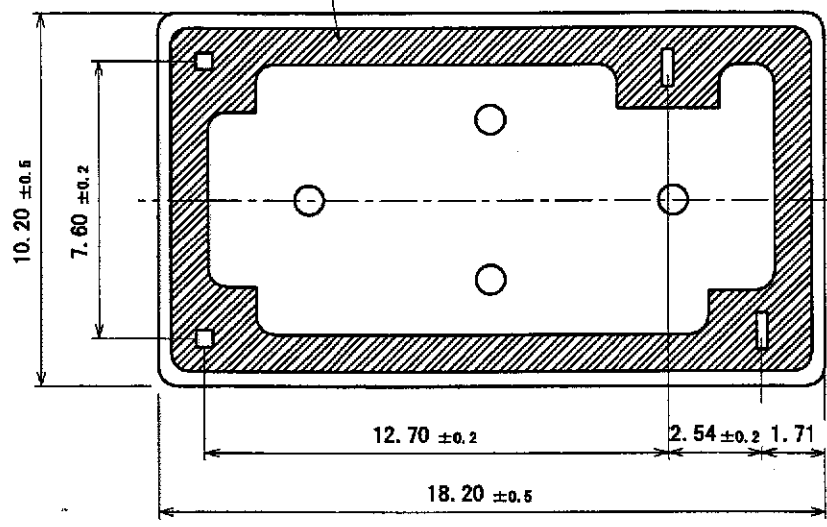
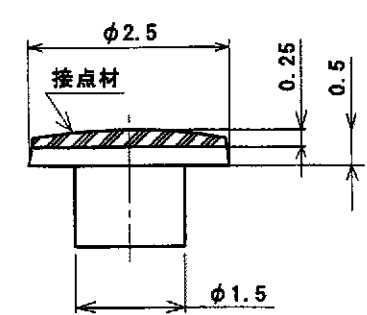


接続図

7 固定接点詳細



8 可動接点詳細



注 シールに依るタイプ分け
 -SS-タイプ: 自動半田槽で半田可能なアンチフラックス型
 -SH-タイプ: 半田付け後PC基板洗浄の可能な型

15	樹脂(シール剤)	エポキシ樹脂			
14	線材	U.E.W			E種
13	ケース	P.B.T		94V-0	三菱 5010GN6-15 E53664
12	ベース	P.B.T		94V-0	三菱 5010GN6-30 E53664
11	ポピン	P.B.T		94V-0	三菱 5010GN6-30 E53664
10	コイル端子	C.P線	半田ディップ		0.45 x 0.45
9	カード	P.P.S		94V-0	東ソ G-10 E102861
8	可動接点	Ag			
7	固定接点	Ag			
6	ヒンジスプリング	PBS			0.12 t
5	A-端子	PBP	半田ディップ		0.3 t
4	C-端子	PBS	半田ディップ		0.12 t
3	鉄芯	S-10R	アニール FNM2		φ3.0
2	アマチュア	SPCCA	アニール FNM2		0.8 t
1	ヨーク	SPCCA	アニール FNM2		1.0 t
分号	名 称	材 質	処 理	自 消 性	そ の 他

作	検	承	尺	品	発
図	図	認	寸	名	行
様	検	認	度	0JE-SS/SH-1**LM	1996年01月24日
取	査	査	1	用途	図番
					U-1123